

September 2024

Bereich: Corporate/Unternehmen

## HEITEC Elektronik: Neue Strukturen in Fertigung und Logistik

### Mehr Effizienz durch Umbau

**Nach der Integration einer zweiten SMT-Linie Mitte 2023 und der Einführung eines Zweischichtbetriebes seit Anfang 2024 passt sich HEITEC mit einer umfangreichen Reorganisation von Intralogistik und Produktion der guten Auftragslage weiter an.**

In einer sich ständig verändernden Welt ist Anpassungsfähigkeit unentbehrlich. Das Geschäftsgebiet Elektronik der HEITEC AG hat Mitte des Jahres begonnen, ihre Niederlassung in Eckental signifikant aus- und umzubauen. Den Maßnahmen liegt eine weitreichende Analyse der Wertströme vom Wareneingang, der Qualitätskontrolle, dem Lager, der Produktion bis hin zum Warenausgang sowie der Vertriebsprognose zugrunde. Das Ziel: Die Erhöhung von Effizienz und Produktivität durch Bereichscluster, mehr Optionen für Elektronikfertigung, Systemmontage und zusätzliche Service-Einrichtungen sowie optimierte, durchgängige Arbeitsabläufe und vereinfachte, verbesserte Wertströme.

Basierend auf der Untersuchung leitete HEITEC ein Konzept für eine neue Intralogistik- und Fertigungsstruktur ab, um den Herausforderungen des Marktes auch künftig flexibel zu begegnen und kontinuierliches Wachstum zu sichern. Lager und Fertigung wurden entzerrt, klar strukturiert, geclustert und ausgebaut. Dies mündete in einer Vergrößerung der Produktionsfläche für Systeme, einer Optimierung des Materialflusses, der Automatisierung von Testsystemen und nicht zuletzt mehr Komfort für die Mitarbeitenden. Die Transformation wurde während des laufenden Betriebs durchgeführt, so dass Produktionsausfälle nahezu vollständig vermieden werden konnten. Die neuen Möglichkeiten für Systemmontage kommen auch der Bearbeitung eines großen Auftrags für innovative Medizintechnik zugute, der in Eckental für internationale Märkte gefertigt werden soll.

*„Durch den Einsatz fortschrittlichster Technologien und durch kontinuierliche Optimierung der Abläufe in den maschinellen, aber auch manuellen Fertigungsbereichen, sowie den Wegen zwischen den unterschiedlichen Produktionsschritten passen wir uns den Marktgegebenheiten und dem Geschäftswachstum dynamisch an. Die Optimierungen enden jedoch nicht bei den Produktionseinrichtungen, sondern erstrecken sich auch über alle (abteilungsübergreifenden) Prozesse, die an einem reibungslosen Ablauf der Produktion beteiligt sind. Nicht zuletzt verbessern ein optimierter Produktionsprozess und ein eingebettetes, kontrolliertes Lifecycle-Management unsere Flexibilität, Kundenorientierung und somit auch unsere Wettbewerbsfähigkeit“, so Stefan Pechtel, Leiter Operations und stellv. Geschäftsgebietsleiter HEITEC Elektronik.*

## **Erweiterte Optionen für die Systemfertigung**

Infolge der jüngsten günstigen Auftragsentwicklung hatte der Ausbau der Systemmontage oberste Priorität. Zur Umsetzung des Konzeptes wurde ca. 2000 m<sup>2</sup> vermieteter Lagerbereich wieder in die Eigennutzung überführt, wodurch die Produktionsfläche für Systeme nahezu verdoppelt wurde. Auch wurden Montagetätigkeiten aus dem Bereich der Elektronikfertigung in den Bereich der Systemfertigung transferiert, so dass dieser ebenfalls neu und mit zusätzlichen Arbeitsplätzen zukunftsgerichtet gestaltet wurde. Die Bearbeitung von (Groß-)Projekten findet nun zentriert in einem Bereich statt, der mit einer optionalen Expansionsfläche alle Flexibilität bietet, um sich auf unterschiedlichste Anforderungen und Kundenwünsche einzustellen.

Im Lager wurden die Wege zwischen Wareneingang, Wareneingangsprüfung und anschließender Einlagerung auf einer Ebene zusammengefasst und optimiert. Die Transportwege sowie die Möglichkeiten für Komponentenbevorratung und Materialfluss wurden reorganisiert und ausgebaut.

## **Verbesserter Workflow, zusätzliche Servicebereiche und optimierte Arbeitsbedingungen**

Das Prüffeld in der Elektronikfertigung unterzog HEITEC ebenfalls einer Entzerrung und Neustrukturierung. Ein Flying Probe Tester wurde mit einem Leiterplatten Be-/Entladesystem so weit automatisiert, dass ein manuelles Handling nahezu komplett entfällt. Als Inhouse-Test- und Prüfverfahren stehen außerdem automatische optische Inspektion (AOI), Boundary Scan-, Röntgen-, Funktions-, Hochspannungs- sowie Grenzbelastungstests und Klimaprüfungen zur Verfügung.

Auch die Optimierung der Arbeitsbedingungen war ein wichtiger Aspekt: Konzentrierte Arbeitsprozesse und kurze Wege durch Bereichs-Cluster, neue Aufenthaltsräume und Sozialbereiche sollen zukünftig den Komfort für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter erhöhen und den Austausch der Teams noch enger gestalten.

Alle notwendigen Umbauten, wie z. B. das Auftragen von 1.000 m<sup>2</sup> ESD-Boden, führte HEITEC planmäßig so durch, dass das operative Geschäft nicht beeinträchtigt wurde. Die Schritte sind darauf ausgelegt, eine weitere Anpassung und Automatisierung bestehender Anlagen zu ermöglichen und je nach Bedarf schnell umzusetzen. Für künftige Aufgaben ist die Niederlassung damit gut gerüstet.

## **Firmenprofil der HEITEC AG**

HEITEC steht für Industriekompetenz in Automatisierung, Digitalisierung, Elektronik sowie Anlagen- und Sondermaschinenbau und bietet Lösungen, Produkte und Dienstleistungen. Mit technisch hochwertigen, verlässlichen und wirtschaftlichen Lösungen unterstützt HEITEC über 2.000 Kunden, ihre Produktivität zu steigern und ihre Produkte zu optimieren. Mehr als 1.200 Mitarbeiter an zahlreichen Standorten im In- und Ausland gewährleisten Kundennähe und Branchenkompetenz.

Im Kompetenzcenter für Elektronik entwickelt und fertigt HEITEC kundenspezifische Elektronikprodukte und -systeme vom einfachen Board bis hin zu komplexen Systemen bestehend aus Hardware, Embedded Software, Applikations-Software und Gehäusetechnik. HEITEC verfügt über ein profundes, technisches

Spezialwissen und kennt auch die spezifischen Anforderungen regulierter Branchen. Unsere Entwicklungs- und Produktionsprozesse sind darauf abgestimmt, auditiert und zertifiziert. Weitere Informationen erhalten Sie unter <https://www.heitec.de/>

**Ansprechpartner HEITEC AG**

**Business Unit Electronics**

Lisa Richter

Dr.-Otto-Leich-Str. 16

90542 Eckental

TEL +49 9126 2934-0

MAIL [elektronik@heitec.de](mailto:elektronik@heitec.de)

WEB <https://elektronik.heitec.de>

**Pressekontakt**

**MIKE ROTH - Concept. Artwork. Publishing.**

Sylvia König

Rosenheimer Straße 32

83083 Riedering

TEL +49 89 58966720

MAIL [skoenig-pr@mikeroth.de](mailto:skoenig-pr@mikeroth.de)

**Bildmaterial**

© HEITEC



Der Fertigungsbereich in Eckental nach dem Umbau- und Ausbau.